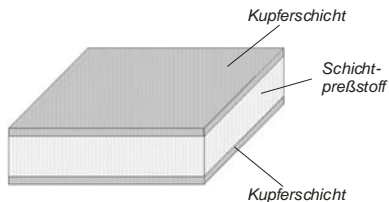


Abbildung 26: Metallresisttechnik

Herstellung von:

- zweiseitigen durchkontaktierten Leiterplatten
- Außenanlagen von Multilayern

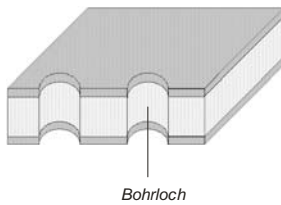


Basismaterial

FR 4 zweiseitig kupferkaschiert

Trägematerial: Glasfasergewebe
Bindemittel: Epoxidharz

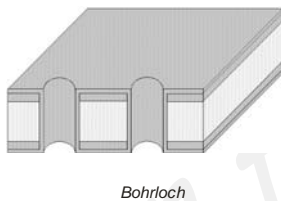
1



Bohren des Lochbilds

Das gesamte Lochbild der Leiterplatte wird gebohrt, also sowohl die später durchmetallisierten als auch die nicht durchmetallisierten Löcher.

2



Leitschicht aufbauen

Auf der gesamten Nutzenoberfläche einschl. der Bohrwandungen wird eine gut haftende Kupferschicht aufgebracht; dies erfolgt durch Kupferabscheidung ohne äußere Stromquelle. Die abgeschiedene Kupferschicht hat eine Dicke von ca. 2 μm .